

FDU6676AS

N-Channel PowerTrench® SyncFET™

30V, 90A, 5.8mΩ

General Description

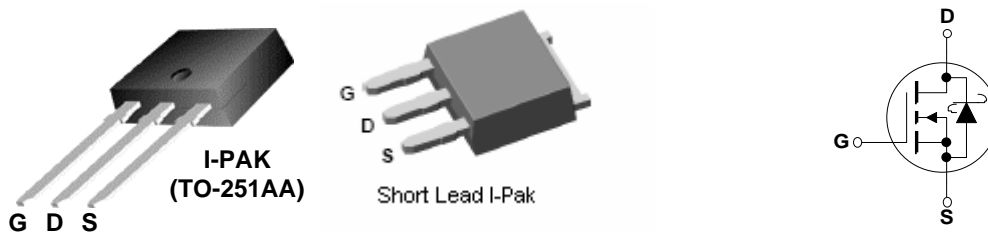
The FDU6676AS is designed to replace a single MOSFET and Schottky diode in synchronous DC/DC power supplies. This 30V MOSFET is designed to maximize power conversion efficiency, providing a low $R_{DS(ON)}$ and low gate charge. The FDU6676AS includes a patented combination of a MOSFET monolithically integrated with a Schottky diode using Fairchild's monolithic SyncFET technology.

Applications

- DC/DC converter

Features

- $R_{DS(ON)} = 5.8m\Omega$ Max, $V_{GS} = 10V$
- $R_{DS(ON)} = 7.3m\Omega$ Max, $V_{GS} = 4.5V$
- High performance trench technology for extremely low $R_{DS(ON)}$
- Low Gate Charge
- High power and current handling capability
- Includes SyncFET Schottky diode



Absolute Maximum Ratings $T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Rated	Units
V_{DSS}	Drain-Source Voltage	30	V
V_{GSS}	Gate-Source Voltage	± 20	V
I_D	Drain Current	-Continuous (Note 1a)	90
		-Pulsed	100
P_D	Power Dissipation for Single Operation (Note 1)	(Note 1a)	70
		(Note 1b)	3.1
		(Note 1c)	1.3
T_J, T_{STG}	Operating and Storage Junction Temperature Range	-55 to +150	$^\circ\text{C}$

Thermal Characteristics

$R_{\theta JC}$	Thermal Resistance junction to Case (Note 1)	1.8	$^\circ\text{C/W}$
$R_{\theta JA}$	Thermal Resistance junction to Ambient (Note 1a)	45	
$R_{\theta JA}$	Thermal Resistance junction to Ambient (Note 1b)	96	

Package Marking and Ordering Information

Device Marking	Device	Package	Reel Size	Tape width	Quantity
FDU6676AS	FDU6676AS	I-PAK (TO-251)	Tube	N/A	75
FDU6676AS	FDU6676AS_NL (Note 4)	I-PAK (TO-251)	Tube	N/A	75
FDU6676AS	FDU6676AS_F071 (Note 5)	I-PAK (TO-251)	Tube	N/A	75

Electrical Characteristics $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
Drain-Source Avalanche Ratings (Note 2)						
W_{DSS}	Drain-Source Avalanche Energy	Single Pulse, $V_{DD} = 15\text{V}$, $I_D = 16\text{A}$		108	250	mJ
I_{AR}	Drain-Source Avalanche Current				16	A

Off Characteristics

BV_{DSS}	Drain-Source Breakdown Voltage	$V_{GS} = 0\text{V}$, $I_D = 250\ \mu\text{A}$	30			V
$\frac{\Delta BV_{DSS}}{\Delta T_J}$	Breakdown Voltage Temperature Coefficient	$I_D = 250\ \mu\text{A}$, Referenced to 25°C		29		$\text{mV}/^\circ\text{C}$
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current	$V_{DS} = 24\text{V}$, $V_{GS} = 0\text{V}$			500	μA
		$V_{DS} = 24\text{V}$, $V_{GS} = 0\text{V}$, $T_J = 125^\circ\text{C}$		13		mA
I_{GSS}	Gate-Body Leakage	$V_{GS} = \pm 20\text{V}$, $V_{DS} = 0\text{V}$			± 100	nA

On Characteristics (Note 2)

$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 250\ \mu\text{A}$	1	1.5	3	V
$\frac{\Delta V_{GS(th)}}{\Delta T_J}$	Gate Threshold Voltage Temperature Coefficient	$I_D = 250\ \mu\text{A}$, Referenced to 25°C		-4		$\text{mV}/^\circ\text{C}$
$R_{DS(on)}$	Static Drain-Source On-Resistance	$V_{GS} = 10\text{V}$, $I_D = 16\text{A}$ $V_{GS} = 4.5\text{V}$, $I_D = 10\text{A}$ $V_{GS} = 10\text{V}$, $I_D = 16\text{A}$, $T_J = 125^\circ\text{C}$		4.8 5.8 7.7	5.8 7.3 9.6	$\text{m}\Omega$
g_{FS}	Forward Transconductance	$V_{DS} = 10\text{V}$, $I_D = 16\text{A}$		67		S

Dynamic Characteristics

C_{iss}	Input Capacitance	$V_{DS} = 15\text{V}$, $V_{GS} = 0\text{V}$, $f = 1.0\text{MHz}$		2470		pF
C_{oss}	Output Capacitance			710		pF
C_{riss}	Reverse Transfer Capacitance			260		pF
R_G	Gate Resistance	$V_{GS} = 100\text{mV}$, $f = 1.0\text{MHz}$		1.8		Ω

Switching Characteristics (Note 2)

$t_{d(on)}$	Turn-On Delay Time	$V_{DD} = 15\text{V}$, $I_D = 1\text{A}$, $V_{GS} = 10\text{V}$, $R_{GEN} = 6\ \Omega$		12	22	ns
t_r	Turn-On Rise Time			12	22	ns
$t_{d(off)}$	Turn-Off Delay Time			50	80	ns
t_f	Turn-Off Fall Time			25	40	ns
$t_{d(on)}$	Turn-On Delay Time	$V_{DD} = 15\text{V}$, $I_D = 1\text{A}$, $V_{GS} = 4.5\text{V}$, $R_{GEN} = 6\ \Omega$		20	32	ns
t_r	Turn-On Rise Time			24	38	ns
$t_{d(off)}$	Turn-Off Delay Time			34	54	ns
t_f	Turn-Off Fall Time			26	42	ns
Q_g	Total Gate Charge, $V_{GS} = 10\text{V}$	$V_{DS} = 15\text{V}$, $I_D = 16\text{A}$		46	64	nC
Q_g	Total Gate Charge, $V_{GS} = 5\text{V}$			25	35	nC
Q_{gs}	Gate-Source Charge			6		nC
Q_{gd}	Gate-Drain Charge			7		nC

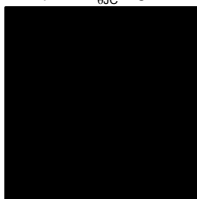
Electrical Characteristics

$T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
Drain–Source Diode Characteristics and Maximum Ratings						
I_S	Maximum Continuous Drain–Source Diode Forward Current				2.3	A
V_{SD}	Drain–Source Diode Forward Voltage	$V_{GS} = 0\text{ V}, I_S = 2.3\text{ A}$ (Note 2)		0.4	1.2	V
t_{rr}	Diode Reverse Recovery Time	$I_F = 16\text{ A}, di_F/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$		28		ns
Q_{rr}	Diode Reverse Recovery Charge			19		nC

Notes:

1. $R_{\theta JA}$ is the sum of the junction-to-case and case-to-ambient thermal resistance where the case thermal reference is defined as the solder mounting surface of the drain pins. $R_{\theta JC}$ is guaranteed by design while $R_{\theta CA}$ is determined by the user's board design.



a) $R_{\theta JA} = 45^\circ\text{C/W}$ when mounted on a 1 in^2 pad of 2 oz copper



b) $R_{\theta JA} = 96^\circ\text{C/W}$ when mounted on a minimum pad.

Scale 1 : 1 on letter size paper

2. Pulse Test: Pulse Width < $300\mu\text{s}$, Duty Cycle < 2.0%

3. Maximum current is calculated as:
$$\sqrt{\frac{P_D}{R_{DS(on)}}}$$

where P_D is maximum power dissipation at $T_C = 25^\circ\text{C}$ and $R_{DS(on)}$ is at $T_{J(max)}$ and $V_{GS} = 10\text{V}$. Package current limitation is 21A

4. FDU6676AS_NL is a lead free product. The FDU6676AS_NL marking will appear on the reel label.
5. FDU6676AS_F071 is a lead free product. The FDU6676AS_F071 marking will appear on the reel label.

Typical Characteristics

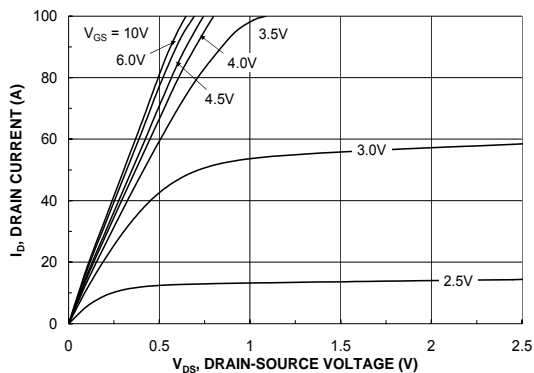


Figure 1. On-Region Characteristics

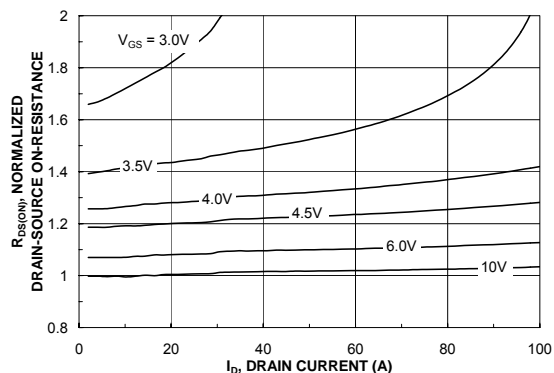


Figure 2. On-Resistance Variation with Drain Current and Gate Voltage

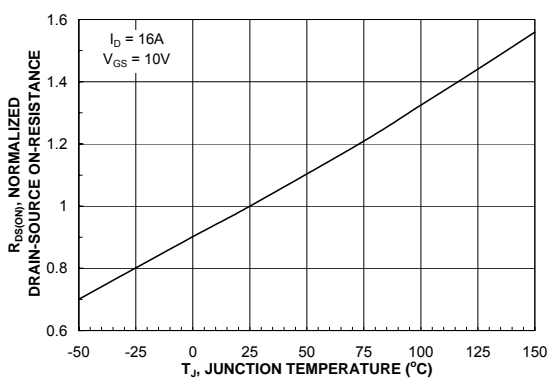


Figure 3. On-Resistance Variation with Temperature

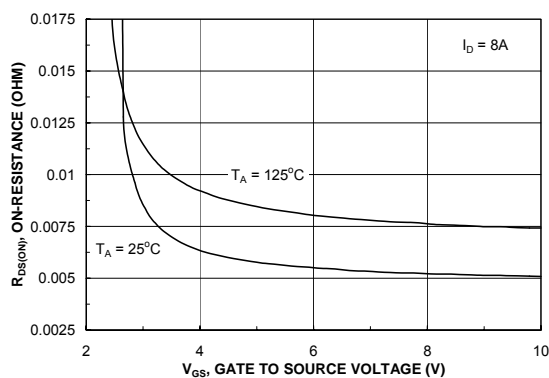


Figure 4. On-Resistance Variation with Gate-to-Source Voltage

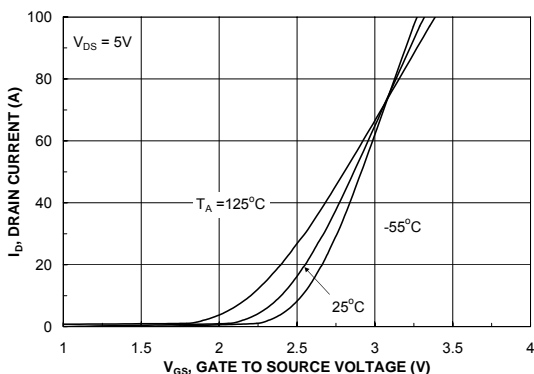


Figure 5. Transfer Characteristics

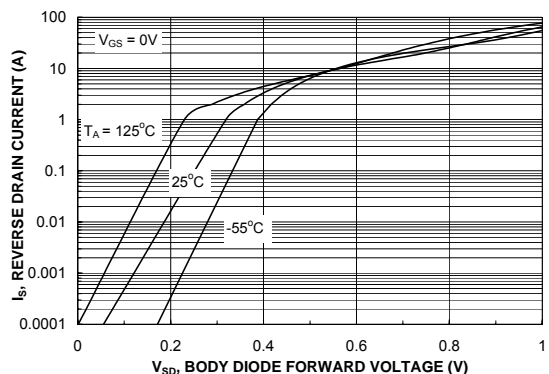


Figure 6. Body Diode Forward Voltage Variation with Source Current and Temperature

Typical Characteristics

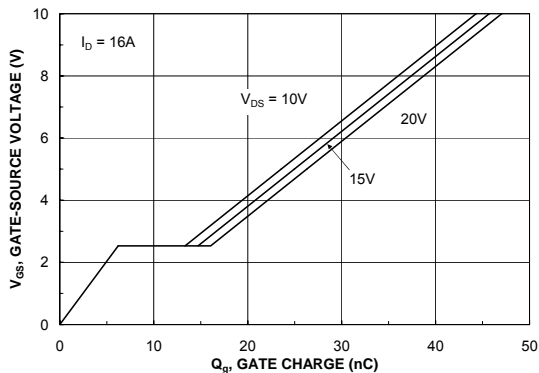


Figure 7. Gate Charge Characteristics

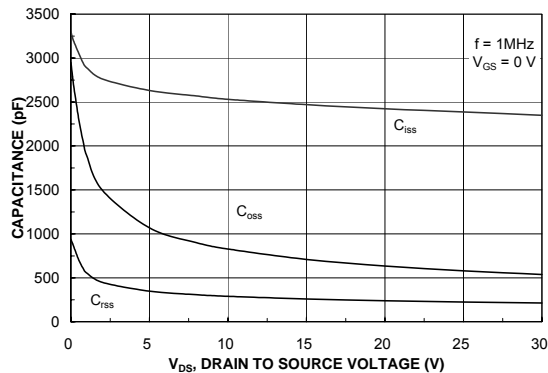


Figure 8. Capacitance Characteristics

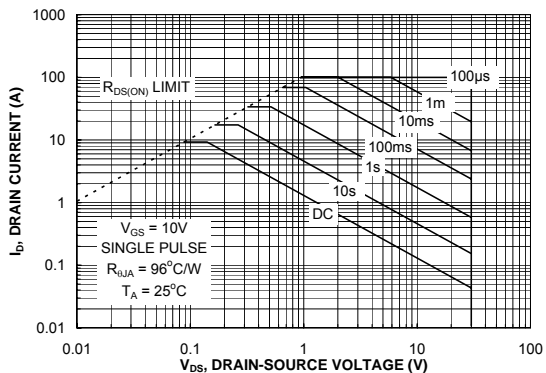


Figure 9. Maximum Safe Operating Area

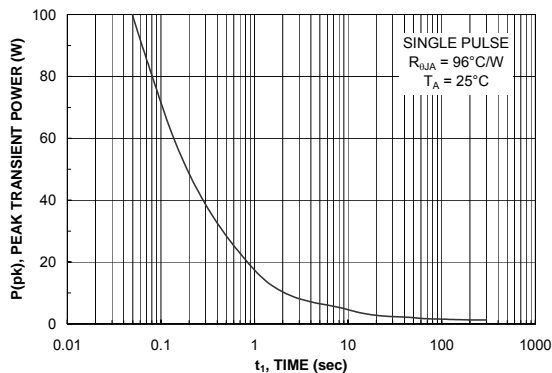


Figure 10. Single Pulse Maximum Power Dissipation

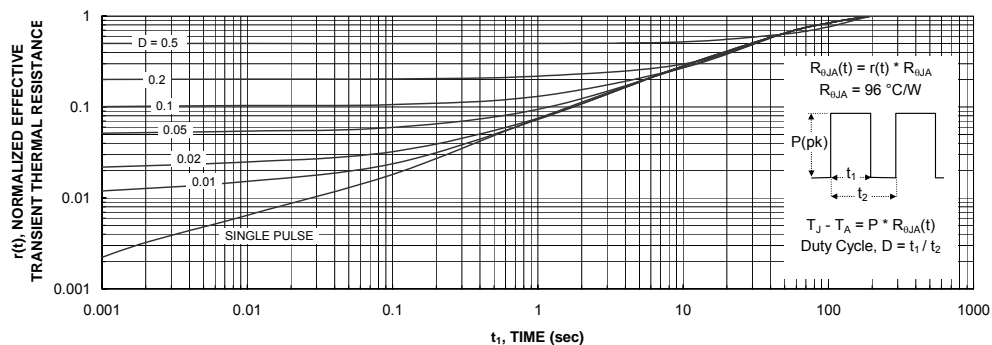


Figure 11. Transient Thermal Response Curve

Thermal characterization performed using the conditions described in Note 1b. Transient thermal response will change depending on the circuit board design.

Typical Characteristics (continued)

SyncFET Schottky Body Diode Characteristics

Fairchild's SyncFET process embeds a Schottky diode in parallel with PowerTrench MOSFET. This diode exhibits similar characteristics to a discrete external Schottky diode in parallel with a MOSFET. Figure 12 shows the reverse recovery characteristic of the FDU6676AS.

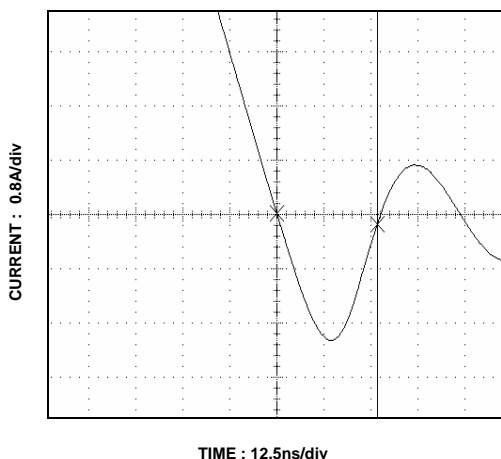


Figure 12. FDU6676AS SyncFET Body Diode Reverse Recovery Characteristic.

For comparison purposes, Figure 13 shows the reverse recovery characteristics of the body diode of an equivalent size MOSFET produced without SyncFET (FDU6676A).

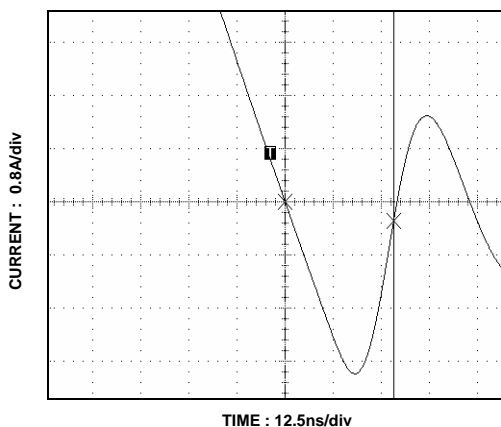


Figure 13. Non-SyncFET (FDU6676A) Body Diode Reverse Recovery Characteristic.

Schottky barrier diodes exhibit significant leakage at high temperature and high reverse voltage. This will increase the power in the device.

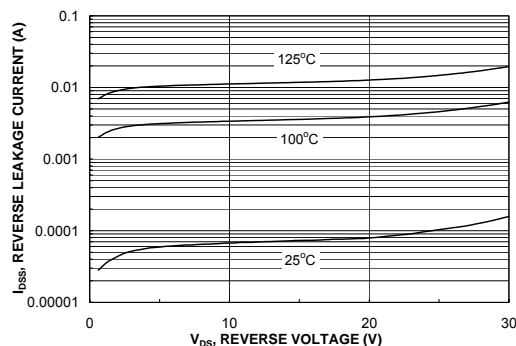


Figure 14. SyncFET Body Diode Reverse Leakage Versus Drain-Source Voltage and Temperature.

TRADEMARKS

The following are registered and unregistered trademarks Fairchild Semiconductor owns or is authorized to use and is not intended to be an exhaustive list of all such trademarks.

ACEx™	FAST®	ISOPLANAR™	PowerSaver™	SuperSOT™-6
ActiveArray™	FASTr™	LittleFET™	PowerTrench®	SuperSOT™-8
Bottomless™	FPST™	MICROCOUPLER™	QFET®	SyncFET™
Build it Now™	FRFET™	MicroFET™	QS™	TinyLogic®
CoolFET™	GlobalOptoisolator™	MicroPak™	QT Optoelectronics™	TINYOPTO™
CROSSVOLT™	GTO™	MICROWIRE™	Quiet Series™	TruTranslation™
DOME™	HiSeC™	MSX™	RapidConfigure™	UHC™
EcoSPARK™	I ² C™	MSXPro™	RapidConnect™	UltraFET®
E ² C MOS™	i-Lo™	OCX™	μSerDes™	UniFET™
EnSigna™	ImpliedDisconnect™	OCXPro™	ScalarPump™	VCX™
FACT™	IntelliMAX™	OPTOLOGIC®	SILENT SWITCHER®	Wire™
FACT Quiet Series™		OPTOPLANAR™	SMART START™	
Across the board. Around the world.™		PACMAN™	SPM™	
The Power Franchise®		POP™	Stealth™	
Programmable Active Droop™		Power247™	SuperFET™	
		PowerEdge™	SuperSOT™-3	

DISCLAIMER

FAIRCHILD SEMICONDUCTOR RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT FURTHER NOTICE TO ANY PRODUCTS HEREIN TO IMPROVE RELIABILITY, FUNCTION OR DESIGN. FAIRCHILD DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY ARISING OUT OF THE APPLICATION OR USE OF ANY PRODUCT OR CIRCUIT DESCRIBED HEREIN; NEITHER DOES IT CONVEY ANY LICENSE UNDER ITS PATENT RIGHTS, NOR THE RIGHTS OF OTHERS.

LIFE SUPPORT POLICY

FAIRCHILD'S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORPORATION. As used herein:

1. Life support devices or systems are devices or systems which, (a) are intended for surgical implant into the body, or (b) support or sustain life, or (c) whose failure to perform when properly used in accordance with instructions for use provided in the labeling, can be reasonably expected to result in significant injury to the user.
2. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

PRODUCT STATUS DEFINITIONS

Definition of Terms

Datasheet Identification	Product Status	Definition
Advance Information	Formative or In Design	This datasheet contains the design specifications for product development. Specifications may change in any manner without notice.
Preliminary	First Production	This datasheet contains preliminary data, and supplementary data will be published at a later date. Fairchild Semiconductor reserves the right to make changes at any time without notice in order to improve design.
No Identification Needed	Full Production	This datasheet contains final specifications. Fairchild Semiconductor reserves the right to make changes at any time without notice in order to improve design.
Obsolete	Not In Production	This datasheet contains specifications on a product that has been discontinued by Fairchild semiconductor. The datasheet is printed for reference information only.



Поставка электронных компонентов

Юридический адрес организации:
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.
Фактический адрес организации:
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, кор. 4, лит А.
ИНН 780277764
КПП 780501001
Р/С 40702810422510004035 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703
БИК 044030703
Телефон: 8 (812) 309-44-11 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 309-44-11
Электронная почта: sales@timechips.ru
Сайт: timechips.ru

Информационное письмо

Компания «ТаймЧипс» - одна из наиболее динамично развивающихся компаний в сфере поставок электронных компонентов. Мы поставляем широкую номенклатуру электронных компонентов отечественных и импортных производителей, как напрямую, так и с крупных мировых складов, позволяющих охватить выборочную номенклатуру более 300 брендов, а также специализируемся на поставках дисплеев и является официальным дистрибьютором компании Shenzhen Startek Electronic Technology Co, на территории Российской Федерации.

Наличие собственной логистики позволяет в кратчайшие сроки доставлять товар нашим клиентам. В нашей компании имеется Конструкторский отдел, где наши специалисты проводят технические консультации клиентов, квалифицированную поддержку и помощь российским разработчикам. Осуществляем Поставки импортной продукции под контролем ВП МО РФ, на предприятия Оборонно-промышленного комплекса России. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

Благодаря нацеленности на результат, мы уверенно занимаем новые позиции на рынке, заинтересовывая Клиента не только актуальными ценами и гибким подходом, но и постоянным вниманием.

Миссия – обеспечение долгосрочного и взаимовыгодного партнерства с клиентами.

Наша цель – Обеспечение клиентам самого широкого ассортимента электронных компонентов и бесперебойности поставок.

Мы - это развитие! Мы задаем темп! Мы разные, но вместе! Мы работаем для вас!

Так же имеем прямые поставки от производителей:

TAI-SAW Пав-компоненты (www.taisaw.com)

TRANSCOM СВЧ-компоненты (www.transcominc.com.tw)

Mini Circuits ВЧ-СВЧ-компоненты (minicircuits.com)

SAMTEC- разъемы (www.samtec.com)

4Star Разъемы РЧ (Даташиты по продукции 4Star, которые Вы сможете загрузить по этой ссылке: <https://yadi.sk/i/tPjnmGGrpmbYj>)

ULNION Преобразователи напряжения (converterdc.com/)

Отличные рекомендации на рынке, уверенность в качестве поставляемой продукции делают нас надежными партнерами для наших клиентов.

«ТаймЧипс» - это:

- Гарантия качества поставляемой продукции;
- Широкий ассортимент;
- Минимальные сроки поставок;
- Техническая поддержка;
- Подбор комплектации;
- Индивидуальный подход;
- Гибкие цены.

Модули, микросхемы, пассивные компоненты, Xilinx (XC), Altera (EP,EPF, EPM) и силовая электроника – это наши ведущие позиции, на поставку которых мы гарантированно дадим Вам самые выгодные предложения!

В структуру компании так же входит конструкторский отдел, который помогает разработчикам и конструкторам в решении следующих задач:

- Оценка стоимости проекта по компонентам;
- Подбор оптимального решения при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Техническая поддержка;
- Консультации у производителей;
- Поставка прототипов;

С Уважением, Чернов Павел.

Руководитель отдела продаж ООО "ТАЙМЧИПС"

Официальный дистрибьютор Shenzhen Startek Electronic Technology Co.,Ltd в России (USB Display Modules , LED Displays, Serial Modules).

<http://www.timechips.ru/>

<http://lcd-timechips.ru/>

Телефон: +7 (812) 309-44-11 доб. 141

Факс: +7 (812) 309-44-11 доб. 152

Моб. Тел. +7 (905) 232-40-65

Skype: time.chips5

Электронная почта: manager1@timechips.ru
